

超配（维持）

## 行业复苏趋势延续，Q2 业绩实现增长

半导体行业 2024 年半年报业绩综述

2024 年 9 月 4 日

## 投资要点：

分析师：刘梦麟

SAC 执业证书编号：

S0340521070002

电话：0769-22110619

邮箱：

liumenglin@dgzq.com.cn

分析师：陈伟光

SAC 执业证书编号：

S0340520060001

电话：0769-22119430

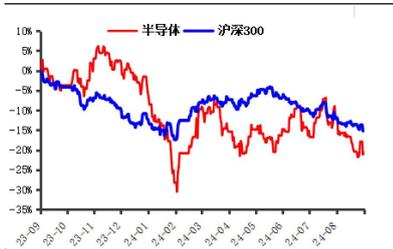
邮箱：

chenweiguang@dgzq.com.cn

- **半导体板块整体业绩：行业景气度强势复苏，24Q2营收、归母净利润实现同比、环比增长。**2024年上半年营业收入2,788.31亿元，同比增长22.01%，实现归母净利润179.21亿元，同比增长11.61%；分季度来看，半导体板块24Q2实现营收1,465.21亿元，同比+22.94%，环比+15.09%，实现归母净利润111.38亿元，同比+15.91%，环比+64.21%。盈利能力方面，申万半导体板块2024年上半年销售毛利率和净利率分别为25.00%和6.02%，相比上年同期分别下降1.62和1.05个百分点，24Q2销售毛利率和净利率分别为25.63%和7.29%，相比上年同期分别下降1.03和0.60个百分点，环比24Q1分别提升1.37和2.75个百分点。进入2024年以后，随着终端厂商和供应链企业积极推进库存去化，叠加AI驱动行业创新，刺激手机、PC开启新一轮换机，半导体行业开始复苏；从板块Q2业绩看，半导体行业复苏趋势延续，板块单季度营收、净利润实现同比、环比增长，且盈利能力有所回升，板块存货周转天数持续下降。展望下半年，半导体行业在AI发展和国产替代的双重加持下有望延续复苏趋势，板块业绩有望实现逐季改善。

- **细分板块业绩：1) 半导体设备：国产替代进程加速，板块Q2业绩高增。**半导体设备板24H1实现营收287.61亿元，同比+38.45%，实现归母净利润51.25亿元，同比+11.95%；板块24Q2实现营收157.58亿元，同比+39.58%，环比+21.19%，24Q2实现归母净利润31.33亿元，同比+4.39%，环比+57.38%。受益晶圆厂建厂潮持续，叠加国产半导体设备在内资晶圆厂中份额提升，申万半导体设备板块24Q2营收、归母净利润实现同比、环比高速增长，行业自主化进程加速；2) **半导体材料：Q2经营业绩实现环比增长，硅片行业复苏缓慢拖累利润表现。**半导体材料板块2024年上半年实现营收196.39亿元，同比+9.76%，实现归母净利润12.19亿元，同比-22.55%；分季度来看，板块24Q2实现营收102.57亿元，同比+13.26%，环比+9.33%，24Q2实现归母净利润7.41亿元，同比-15.01%，环比+55.27%。SEMI预计2024年全球半导体材料市场同比增长4.43，而中国大陆半导体材料板块在快速响应、生产成本方面具有一定优势，整体国产化率较低，伴随内资晶圆厂资本开支实现增长，24Q2营收端实现同比、环比增长；利润方面，以沪硅产业为代表的硅片大厂持续扩充300mm硅片产能，带来固定支出加大拖累整体毛利率，且半导体硅片市场的复苏滞后于终端市场、芯片制造等产业链下游环节，导致公司扣非后净利润连续五个季度为负值，拖累板块整体盈利水平；3) **IC设计：受益终端需求回暖，IC设计板块Q2业绩同比、环比实现大幅增长。**IC设计板块24H1实现营收886.65亿元，同比+31.08%，实现归母净利润64.16亿元，同比+226.60%；分季度来看，板块24Q2实现营收480.93亿元，同比+29.99%，环比+18.54%，24Q2实现归母净利润40.42亿元，同比+148.56%，环比+70.30%。进入2024年以来，IC设计所对应下游终端需求逐步回暖，对应板块24Q2营收同比增长29.99%，表明行业景气度正加速修复。据IDC数据，2024年1-7月全球智能手机出货量为5.75亿台，同比增长7.66%，国内方面，据2024年1-7月国内智能手机累计出货量为1.61亿台，同比增长13.66%。作为半导体行业最重要的下游终端之一，智能手机出货反弹对IC设计企业的业绩构成支撑；其他终端方面，据Canalys

## 半导体行业（申万）指数走势



资料来源：东莞证券研究所，iFind

## 相关报告

本报告的风险等级为中高风险。

本报告的信息均来自已公开信息，关于信息的准确性与完整性，建议投资者谨慎判断，据此入市，风险自担。

请务必阅读末页声明。

数据，2024年第二季度全球PC市场出货量达到6,280万台，同比增长3.4%，为连续两个季度实现同比增长，AI PC的逐步渗透拉动了换机需求，也带动存储、面板等泛半导体零部件的相关需求；4) **半导体封测：封测行业景气回暖，经营业绩强势复苏**。半导体封测板块24H1实现营收386.29亿元，同比+22.95%，实现归母净利润14.90亿元，同比+91.52%；分季度来看，板块24Q2实现营收209.73亿元，同比+25.05%，环比+18.79%，24Q2实现归母净利润10.92亿元，同比+74.77%，环比+173.59%。进入24Q1，随着消费需求趋于稳定、存储器市场回暖、人工智能与高性能计算等热点应用领域带动等因素作用，全球半导体市场重回增长轨道，封测板块作为半导体产业链的下游环节深度受益，业内企业产能利用率、经营业绩均呈恢复态势；5) **集成电路制造：产能利用率逐步修复，Q2利润环比改善**。集成电路制造板块24H1实现营收461.85亿元，同比+10.64%，实现归母净利润19.46亿元，同比-54.68%；分季度来看，板块24Q2实现营收239.86亿元，同比+8.88%，环比+8.05%，实现归母净利润13.00亿元，同比-36.06%，环比+101.60%。2024年，全球晶圆代工行业缓慢复苏，且受地缘政治影响，国内晶圆代工本土化需求加速提升，对应申万晶圆制造板块24Q2营收实现同比、环比改善，但行业面临代工价格下降、折旧费用增加等挑战，影响板块利润表现。以中芯国际为例，公司24Q2营收实现同比、环比增长，但归母净利润同比下降，且盈利能力承压。随着公司12英寸产能持续释放，公司产品组合有望实现优化调整，因此公司预计24Q3收入环比增长13%至15%，毛利率介于18%到20%范围内，指引较为积极。

- **投资策略：半导体行业景气度延续，维持板块超配评级**。进入2024年，伴随着下游需求回暖以及厂商推进库存去化，半导体行业迈入上行周期，从半年报业绩看，半导体行业2024年上半年经营业绩实现同比增长，设备、材料、存储、CIS、封测等细分板块龙头企业Q2业绩大多表现出色，且受益智能手机等消费类电子的强劲需求，苹果、高通、联电等海外企业最新财季业绩高于预期，表明行业景气度延续。展望下半年，随着消费电子旺季的到来和内资晶圆厂产能扩充持续推进，半导体行业景气度有望维持较好水平。可关注Q2业绩表现出色的设备、存储、CIS、封测等细分板块。
- **风险提示：终端需求不及预期、国产替代不及预期、价格竞争加剧等。**

## 目录

1. 半导体行业整体业绩：行业复苏趋势延续，经营业绩持续提升	5
2. 子板块业绩情况	7
2.1 半导体设备：24Q2 营收同比+39.58%，净利润同比+4.39%	7
2.2 半导体材料：24Q2 营收同比+13.26%，净利润同比-15.01%	9
2.3 IC 设计：24Q2 营收同比+29.99%，净利润同比+148.56%	12
2.4 半导体封测：24Q2 营收同比+25.05%，利润同比+74.77%	16
2.5 集成电路制造：24Q2 营收同比+8.88%，归母净利润同比-36.06%	18
3. 投资建议	20
4. 风险提示	21

## 插图目录

图 1：半导体板块 2020H1-2024H1 营收情况	5
图 2：半导体板块 2020H1-2024H1 归母净利润情况	5
图 3：半导体板块 2020Q2-2024Q2 营收情况	5
图 4：半导体板块 2020Q2-2024Q2 归母净利润情况	5
图 5：半导体板块 2020H1-2024H1 毛利率、净利率 (%)	5
图 6：半导体板块 2020Q2-2024Q2 毛利率、净利率	5
图 7：半导体板块报告期末存货周转天数 (2021Q1-2024Q2)	6
图 8：全球半导体月度销售情况	6
图 9：中国半导体月度销售情况	6
图 10：半导体设备板块 2020H1-2024H1 营收情况	7
图 11：半导体设备板块 2020H1-2024H1 归母净利润情况	7
图 12：半导体设备板块 2020Q2-2024Q2 营收情况	7
图 13：半导体设备板块 2020Q2-2024Q2 归母净利润情况	7
图 14：半导体设备板块 2020H1-2024H1 毛利率、净利率 (%)	8
图 15：半导体设备板块 2020Q2-2024Q2 毛利率、净利率	8
图 16：半导体材料板块 2020H1-2024H1 营收情况	10
图 17：半导体材料板块 2020H1-2024H1 归母净利润情况	10
图 18：半导体材料板块 2020Q2-2024Q2 营收情况	10
图 19：半导体材料板块 2020Q2-2024Q2 归母净利润情况	10
图 20：半导体材料板块 2020H1-2024H1 毛利率、净利率 (%)	10
图 21：半导体材料板块 2020Q2-2024Q2 毛利率、净利率	10
图 22：全球半导体材料市场规模预测	11
图 23：IC 设计板块 2020H1-2024H1 营收情况	12
图 24：IC 设计板块 2020H1-2024H1 归母净利润情况	12
图 25：IC 设计板块 2020Q2-2024Q2 营收情况	12
图 26：IC 设计板块 2020Q2-2024Q2 归母净利润情况	12
图 27：IC 设计板块 2020H1-2024H1 毛利率、净利率 (%)	13
图 28：IC 设计板块 2020Q2-2024Q2 毛利率、净利率	13
图 29：全球智能手机季度出货量 (2018/03-2024/06)	13
图 30：国内智能手机月度出货情况 (2022/02-2024/07)	13
图 31：全球台式机和笔记本出货量 (数量单位为千台)	14

图 32: 半导体封测板块 2020H1-2024H1 营收情况 .....	16
图 33: 半导体封测板块 2020H1-2024H1 归母净利润情况 .....	16
图 34: 半导体封测板块 2020Q2-2024Q2 营收情况 .....	16
图 35: 半导体封测板块 2020Q2-2024Q2 归母净利润情况 .....	16
图 36: 半导体封测板块 2020H1-2024H1 毛利率、净利率 (%) .....	16
图 37: 半导体封测板块 2020Q2-2024Q2 毛利率、净利率 .....	16
图 38: 集成电路制造板块 2020H1-2024H1 营收情况 .....	18
图 39: 集成电路制造板块 2020H1-2024H1 归母净利润情况 .....	18
图 40: 集成电路制造板块 2020Q2-2024Q2 营收情况 .....	18
图 41: 集成电路制造板块 2020Q2-2024Q2 归母净利润情况 .....	18
图 42: 集成电路制造板块 2020H1-2024H1 毛利率、净利率 (%) .....	19
图 43: 集成电路制造板块 2020Q2-2024Q2 毛利率、净利率 .....	19

## 表格目录

表 1: 重点公司盈利预测及投资评级 (截至 2024/9/3) .....	21
--	----

## 1. 半导体行业整体业绩：行业复苏趋势延续，经营业绩持续提升

**半导体板块整体业绩：行业景气度强势复苏，24Q2 营收、归母净利润实现同比、环比增长。**选取申万分类标准下“SW 电子——SW 半导体”的所有上市公司，统计半导体板块 2024 年上半年业绩情况。半导体行业 2024 年上半年营业收入 2,788.31 亿元，同比增长 22.01%，实现归母净利润 179.21 亿元，同比增长 11.61%；分季度来看，半导体板块 24Q2 实现营收 1,465.21 亿元，同比+22.94%，环比+15.09%，24Q2 实现归母净利润 111.38 亿元，同比+15.91%，环比+64.21%。

图 1：半导体板块 2020H1-2024H1 营收情况

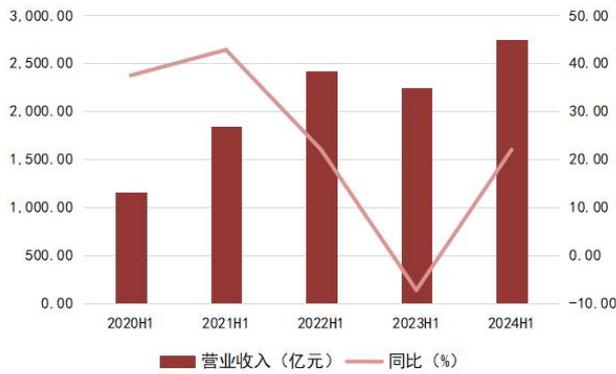
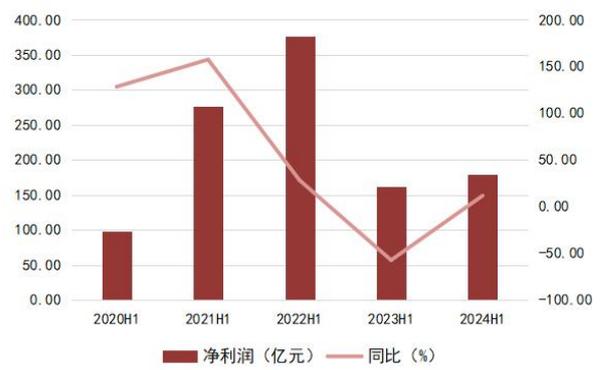


图 2：半导体板块 2020H1-2024H1 归母净利润情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 3：半导体板块 2020Q2-2024Q2 营收情况

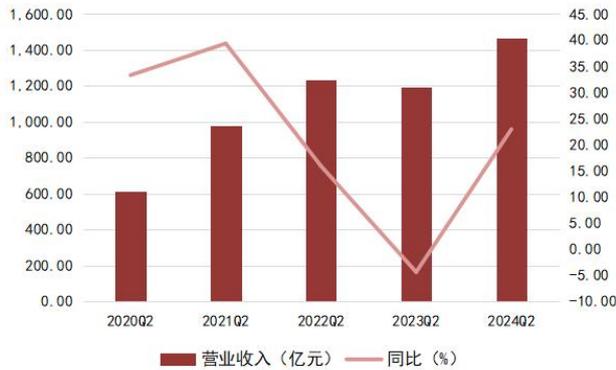


图 4：半导体板块 2020Q2-2024Q2 归母净利润情况

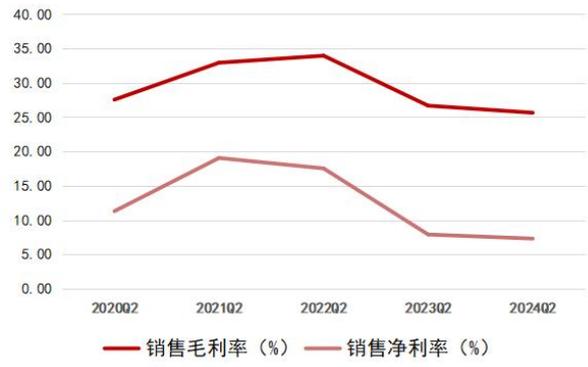


资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

**盈利能力：2024 年第二季度销售毛利率、净利率环比 Q1 有所提升。**盈利能力方面，申万半导体板块 2024 年上半年销售毛利率和净利率分别为 25.00%和 6.02%，相比上年同期分别下降 1.62 和 1.05 个百分点，2024 年二季度销售毛利率和净利率分别为 25.63%和 7.29%，相比上年同期分别下降 1.03 和 0.60 百分点，环比 24Q1 分别提升 1.37 和 2.75 个百分点。

图 5：半导体板块 2020H1-2024H1 毛利率、净利率 (%) 图 6：半导体板块 2020Q2-2024Q2 毛利率、净利率



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

**存货周转：存货周转天数持续下降，行业库存压力减小。** 存货周转方面，板块存货周转天数从 21Q1 开始逐步上行，至 23Q1 达到高点。截至 24Q2 末，半导体板块存货周转天数为 165.35 天，环比 24Q1 减少 5.04 天，相比 23Q2 下降 16.47 天，表明行业去库存推进顺利。展望下半年，随着业内企业持续推进库存去化，预计行业存货周转情况有望继续向好。

图 7：半导体板块报告期末存货周转天数（2021Q1-2024Q2）



数据来源：SEMI，东莞证券研究所

**半导体销售情况：2024 年上半年全球、国内半导体月度销售额同比有所改善。** 根据美国半导体产业协会数据，受益半导体产业链复苏，2024 年上半年全球、中国半导体月度销售额实现同比增长。具体来看，2024 年 1-6 月全球半导体月度销售额合计为 2,860.5 亿美元，同比增长 17.06%，国内半导体月度销售额合计为 872.3 亿美元，同比增长 25.28%。

图 8：全球半导体月度销售情况

图 9：中国半导体月度销售情况



资料来源：美国半导体产业协会，东莞证券研究所



资料来源：美国半导体产业协会，东莞证券研究所

综上所述，进入 2024 年以后，随着终端厂商和供应链企业积极推进库存去化，叠加 AI 驱动行业创新，刺激手机、PC 开启新一轮换机，半导体行业开始复苏；从板块 Q2 业绩看，半导体行业复苏趋势延续，板块单季度营收、净利润实现同比、环比增长，且盈利能力有所回升，板块存货周转天数持续下降。展望下半年，半导体行业在 AI 发展和国产替代的双重加持下有望延续复苏趋势，板块业绩有望实现逐季改善。

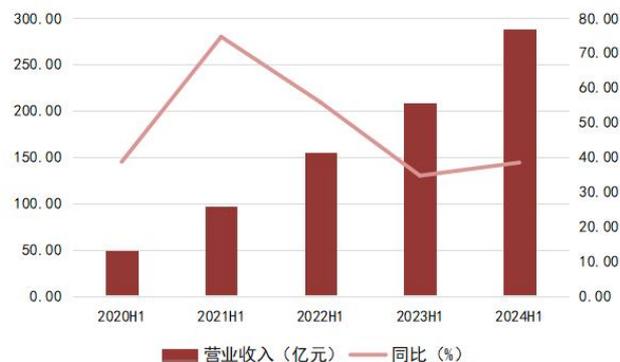
## 2. 子板块业绩情况

### 2.1 半导体设备：24Q2 营收同比+39.58%，净利润同比+4.39%

选取申万半导体行业下的三级行业——“半导体设备”作为半导体设备代表，统计板块 2024 年上半年业绩情况。

**板块业绩：受益国产替代进程加速，半导体设备板块 24Q2 业绩实现同比、环比增长。** 半导体设备板块 2024 年上半年实现营收 287.61 亿元，同比+38.45%，实现归母净利润 51.25 亿元，同比+11.95%；分季度来看，板块 24Q2 实现营收 157.58 亿元，同比+39.58%，环比+21.19%，24Q2 实现归母净利润 31.33 亿元，同比+4.39%，环比+57.38%。

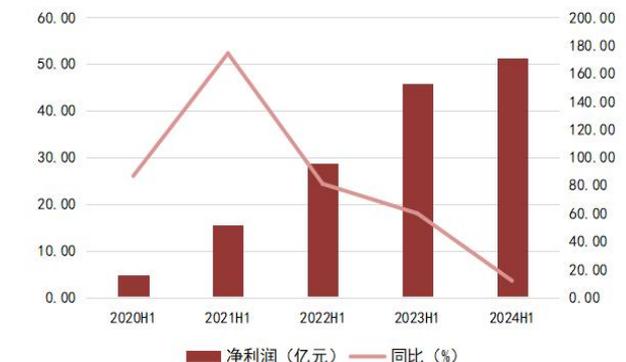
图 10：半导体设备板块 2020H1-2024H1 营收情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 12：半导体设备板块 2020Q2-2024Q2 营收情况

图 11：半导体设备板块 2020H1-2024H1 归母净利润情况

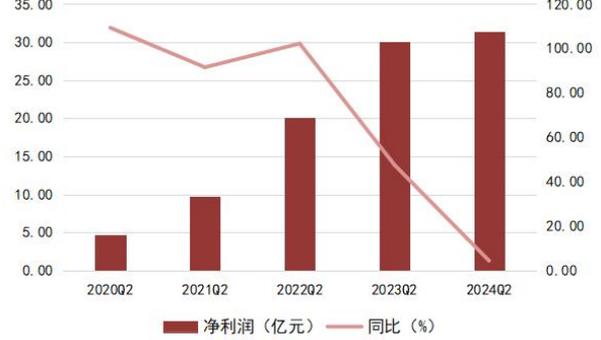


资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 13：半导体设备板块 2020Q2-2024Q2 归母净利润情况



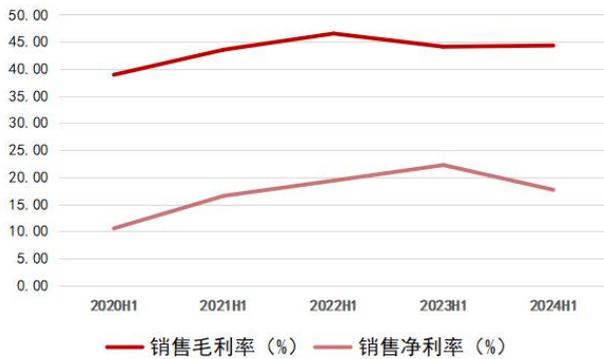
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所



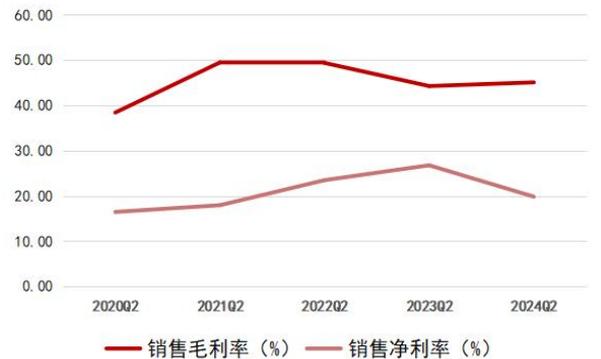
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

**盈利能力：Q2 销售毛利率、净利率实现环比改善。**盈利能力方面，半导体设备板块 2024 年上半年销售毛利率、销售净利率分别为 44.29%和 17.66%，相比上年同期分别提高 0.22 个百分点和下降 4.57 个百分点，板块 24Q2 销售毛利率为 45.06%，同比+0.82pct，环比+1.71pct，板块 24Q2 销售净利率为 19.83%，同比-6.93pct，环比+4.80pct。

图 14：半导体设备板块 2020H1-2024H1 毛利率、净利率图 图 15：半导体设备板块 2020Q2-2024Q2 毛利率、净利率图



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

综上所述，受益晶圆厂建厂潮持续，叠加国产半导体设备在内资晶圆厂中份额提升，申万半导体设备板块 24Q2 营收、归母净利润同比、环比大幅增长，行业自主化进程加速。SEMI 指出，2024 年全球半导体设备市场有望较去年微幅增长 3%至 1,095 亿美元，明年在先进逻辑芯片及封测领域驱动下，设备市场将较今年增长 16%，至 1,275 亿美元规模。晶圆厂产能利用率于今年第一季落底，第二季开始逐步复苏，预期第三季产能利用率可望达 70%，第四季再进一步复苏，有望拉动上游设备需求。国内晶圆厂扩产确定性高，叠加全球半导体周期复苏预期，内资半导体设备企业有望受益。

### 部分半导体设备企业业绩梳理

**北方华创（002371）：**据公司半年报，公司 2024 年上半年实现营收 123.35 亿元，同比

增长 46.38%，实现归母净利润 27.81 亿元，同比增长 54.54%，对应 24Q2 营收为 64.76 亿元，同比增长 42.15%，环比增长 10.52%，对应 24Q2 归母净利润为 16.54 亿元，同比增长 36.98%，环比增长 46.82%。盈利能力方面，公司 2024 年上半年销售毛利率为 47.40%，相比上年同期提高 4.02 个百分点，2024 年上半年销售净利率为 22.54%，相比上年同期提高 0.49 个百分点；分季度来看，公司 24Q2 销售毛利率为 47.40%，同比+4.02pct，环比+4.00pct，公司 24Q2 销售净利率为 25.66%，同比-1.62pct，环比+6.45pct。报告期内，公司继续专注于半导体设备、真空及锂电装备和精密电子元器件三大核心业务板块，在集成电路装备领域继续保持国内领先地位，刻蚀、薄膜沉积、炉管、清洗、快速退火等核心工艺装备突破多项关键技术并实现产业化应用，工艺覆盖度及市场占有率显著增长，带动公司实现业绩增长。

**中微公司（688012）：**据公司半年报，公司 2024 年上半年实现营收 34.48 亿元，同比增长 36.46%，实现归母净利润 5.17 亿元，同比下降 48.48%，对应 24Q2 营收为 18.43 亿元，同比增长 41.37%，环比增长 14.81%，对应 24Q2 归母净利润为 2.68 亿元，同比下降 63.23%，环比增长 7.39%。盈利能力方面，公司 2024 年上半年销售毛利率为 41.32%，相比上年同期下降 4.57 个百分点，2024 年上半年销售净利率为 14.97%，相比上年同期下降 24.70 个百分点；分季度来看，公司 24Q2 销售毛利率为 38.17%，同比-7.73pct，环比-6.77pct，公司 24Q2 销售净利率为 14.51%，同比-41.29pct，环比-0.99pct。报告期内，受益于存储器件制造和先进逻辑制程升级，公司刻蚀设备需求大幅增长，因此营收实现提升，但新会计准则实施导致保证类质保费用计入营业成本影响公司毛利水平，且研发费用大幅增加导致公司盈利能力承压，因此报告期内归母净利润同比大幅下降。公司在披露的投资者关系活动记录表中显示，今年前三季度的累计新增订单预计超过 75 亿元，同比增长超过 50%；预计 2024 年的累计新增订单将达到 110 亿-130 亿元。同时，伴随销售增长，研发投入占营业收入的比例有望逐渐下降。

**华海清科（688120）：**公司 2024 年上半年实现营收 14.97 亿元，同比增长 21.23%，实现归母净利润 4.33 亿元，同比增长 15.65%，对应 24Q2 营收为 8.16 亿元，同比增长 32.03%，环比增长 20.00%，对应 24Q2 归母净利润为 2.31 亿元，同比增长 27.89%，环比增长 14.03%。报告期内，全球半导体行业呈现回暖趋势，叠加 AI、高性能计算等领域快速发展，对芯片性能和功耗要求不断提高，通过内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装的 Chiplet 和基于 2.5D/3D 封装技术将 DRAMDie 垂直堆叠的高带宽存储器（HBM）等先进封装技术和工艺成为未来发展的重要方向。公司产品研发始终坚持以市场和客户需求为导向，持续深耕半导体关键装备与技术服务，一方面基于现有产品不断进行更新迭代，另一方面积极布局新技术新产品的开发拓展，在 CMP 装备、减薄装备及其他产品方面取得了积极成果，因此 24Q2 营收、归母净利润实现同比、环比大幅增长。

## 2.2 半导体材料：24Q2 营收同比+13.26%，净利润同比-15.01%

选取申万半导体行业下的三级行业——“半导体材料”作为半导体材料代表，统计板块 2024 年上半年业绩情况。

**板块业绩：Q2 营收、归母净利润实现环比增长。**半导体材料板块 2024 年上半年实现营收 196.39 亿元，同比+9.76%，实现归母净利润 12.19 亿元，同比-22.55%；分季度来看，板块 24Q2 实现营收 102.57 亿元，同比+13.26%，环比+9.33%，24Q2 实现归母净利润 7.41 亿元，同比-15.01%，环比+55.27%。

图 16：半导体材料板块 2020H1-2024H1 营收情况

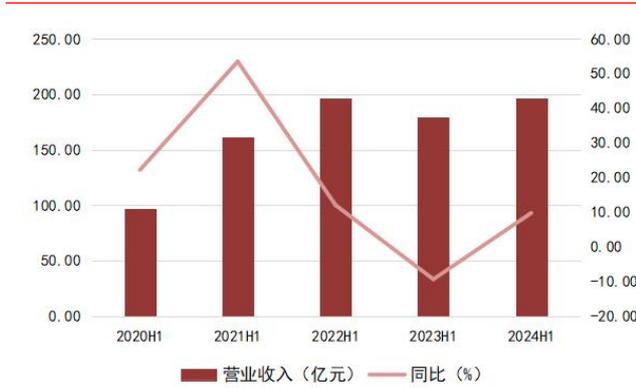


图 17：半导体材料板块 2020H1-2024H1 归母净利润情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 18：半导体材料板块 2020Q2-2024Q2 营收情况

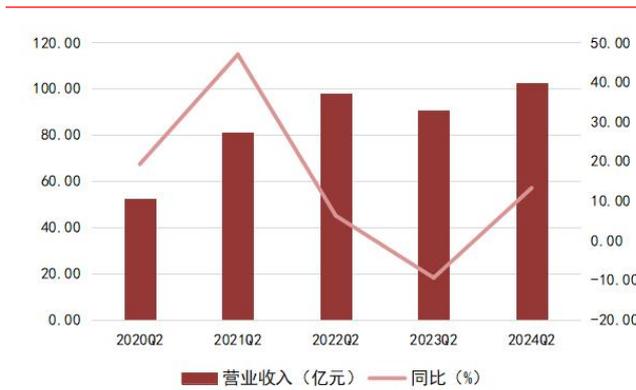
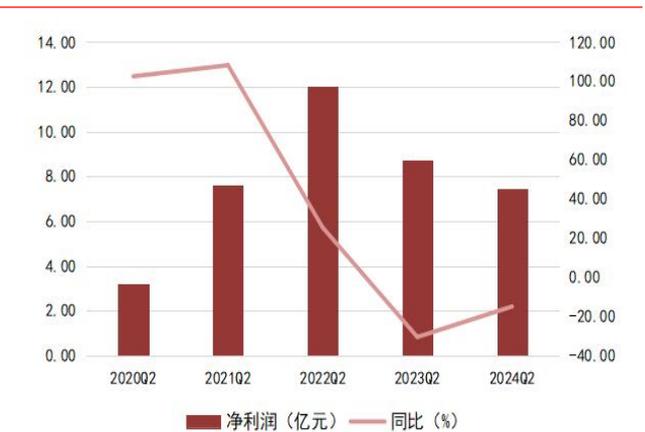


图 19：半导体材料板块 2020Q2-2024Q2 归母净利润情况



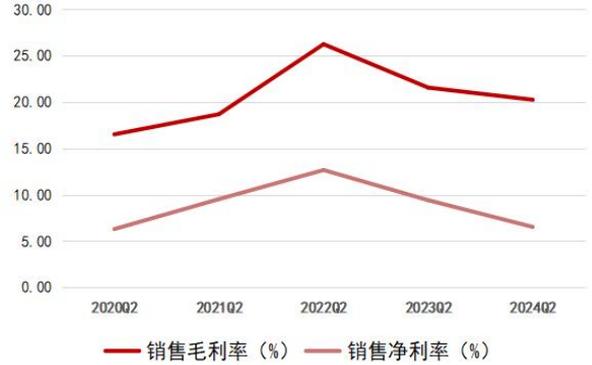
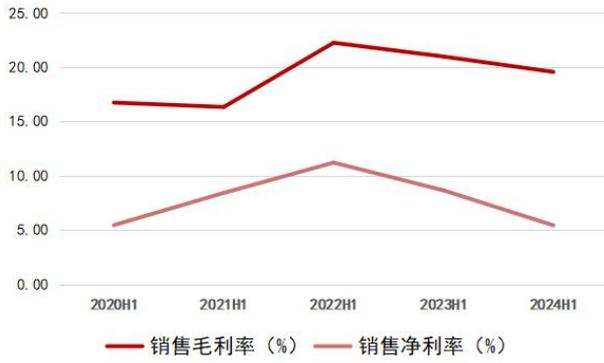
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

**盈利能力：Q2 销售毛利率、净利率同比下滑但环比提升。**盈利能力方面，半导体设备板块 2024 年上半年销售毛利率、销售净利率分别为 19.56%和 5.44%，相比上年同期分别下降 1.41pct 和 3.22pct，板块 24Q2 销售毛利率为 20.24%，同比-1.31pct，环比+1.43pct，板块 24Q2 销售净利率为 6.52%，同比-2.89pct，环比+2.27pct。

图 20：半导体材料板块 2020H1-2024H1 毛利率、净利率图

图 21：半导体材料板块 2020Q2-2024Q2 毛利率、净利率

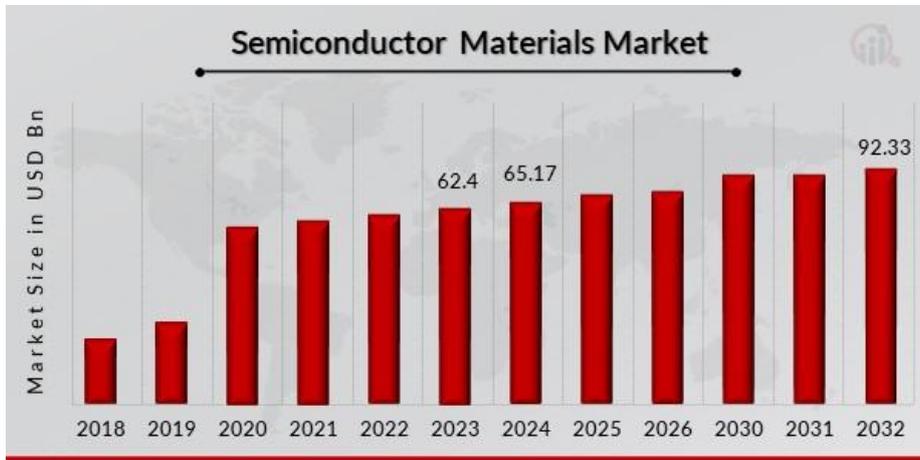


资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

据 SEMI 数据,2023 年全球半导体材料市场规模为 624 亿美元,预计 2024 年将达到 651.7 亿美元,同比增长 4.43%。SEMI 指出,受益全球半导体市场规模扩张,预计半导体材料行业市场规模将从 2024 年的 651.7 亿美元增长至 2032 年的 923.3 亿美元,2024-2032 年复合增长率为 4.45%。中国大陆半导体材料板块在快速响应、生产成本方面具有一定优势,整体国产化率较低,伴随内资晶圆厂资本开支实现增长,24Q2 营收端实现同比、环比增长;利润方面,以沪硅产业为代表的硅片大厂持续扩充 300mm 硅片产能,带来固定支出加大拖累整体毛利率,且半导体硅片市场的复苏滞后于终端市场、芯片制造等产业链下游环节,导致公司扣非后净利润连续五个季度为负值,拖累板块整体盈利水平。

图 22：全球半导体材料市场规模预测



数据来源：SEMI，东莞证券研究所

### 部分半导体材料企业业绩梳理

**江丰电子 (300666)：**公司 2024 年上半年实现营收 16.27 亿元,同比增长 35.91%,实现归母净利润 1.61 亿元,同比增长 5.32%,对应 24Q2 营收为 8.55 亿元,同比增长 35.25%,环比增长 10.70%,对应 24Q2 归母净利润为 1.01 亿元,同比增长 4.27%,环比增长 70.15%。报告期内公司超高纯靶材和精密零部件业务均实现快速增长,营收创历史新高,且得益于公司在先进制程产品竞争力的强化和全球市场份额的扩大,以及在精密零部件领域的

战略布局和生产基地的建设，公司盈利能力实现提升。

**鼎龙股份（300054）：**公司 2024 年上半年实现营收 15.19 亿元，同比增长 31.01%，实现归母净利润 2.18 亿元，同比增长 127.22%，对应 24Q2 营收为 8.11 亿元，同比增长 32.35%，环比增长 14.52%，对应 24Q2 归母净利润为 1.36 亿元，同比增长 122.88%，环比增长 67.04%。报告期内，公司聚焦于半导体制造用 CMP 工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，并在传统打印复印通用耗材业务领域进行了全产业链布局，受益于下游晶圆厂和面板厂的稼动率回升，以及新产品 PI、抛光液等快速上量，公司 24Q2 经营业绩实现同比增长，且利润率水平持续提升。

**雅克科技（002409）：**公司 2024 年上半年实现营收 32.57 亿元，同比增长 40.21%，实现归母净利润 5.20 亿元，同比增长 52.19%，对应 24Q2 营收为 16.38 亿元，同比增长 30.91%，环比增长 1.25%，对应 24Q2 归母净利润为 2.74 亿元，同比增长 62.44%，环比增长 11.28%。报告期内，公司主要业务为电子材料业务、LNG 保温绝热板材业务、阻燃剂业务。报告期内，得益于终端补库存需求和 AI 等带来的集成电路需求，公司前驱体材料销售增长明显，目前产品已覆盖国内主要存储芯片厂商、逻辑芯片厂商，并开始为功率器件、射频和图形处理等功能芯片的厂商送样测试；此外，公司加大研发投入，丰富产品种类，并积极推进新产品在客户端的测试。

### 2.3 IC 设计：24Q2 营收同比+29.99%，净利润同比+148.56%

选取申万半导体行业下的三级行业——“数字芯片设计”“模拟芯片设计”作为 IC 设计代表，统计板块 2024 年上半年业绩情况。

**板块业绩：受益终端需求回暖，IC 设计板块 Q2 业绩同比、环比实现大幅增长。**IC 设计板块 2024 年上半年实现营收 886.65 亿元，同比+31.08%，实现归母净利润 64.16 亿元，同比+226.60%；分季度来看，板块 24Q2 实现营收 480.93 亿元，同比+29.99%，环比+18.54%，24Q2 实现归母净利润 40.42 亿元，同比+148.56%，环比+70.30%。

图 23：IC 设计板块 2020H1-2024H1 营收情况

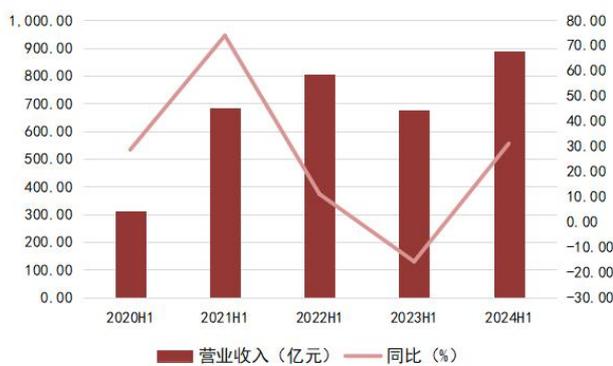
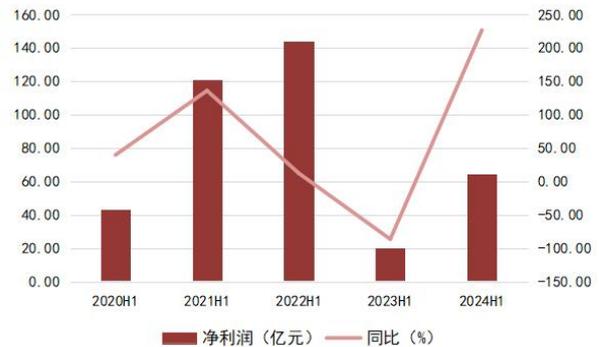


图 24：IC 设计板块 2020H1-2024H1 归母净利润情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

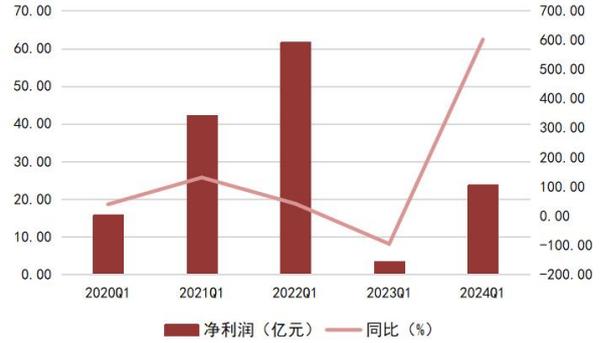
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 25：IC 设计板块 2020Q2-2024Q2 营收情况

图 26：IC 设计板块 2020Q2-2024Q2 归母净利润情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所



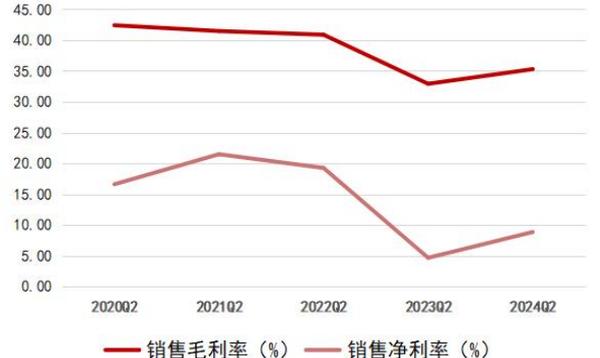
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

**盈利能力：24Q2 销售毛利率同比、环比有所提高。** 盈利能力方面，IC 设计板块 2024 年上半年销售毛利率、销售净利率分别为 34.83% 和 7.55%，相比上年同期分别提高 1.18pct 和 4.42pct，板块 24Q2 销售毛利率为 35.28%，同比+2.38pct，环比+0.98pct，板块 24Q2 销售净利率为 8.87%，同比+4.19pct，环比+2.88pct。

图 27：IC 设计板块 2020H1-2024H1 毛利率、净利率（%）图 28：IC 设计板块 2020Q2-2024Q2 毛利率、净利率



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

综上所述，进入 2024 年以来，IC 设计所对应下游终端需求逐步回暖，对应板块 24Q2 营收同比增长 29.99%，表明行业景气度正加速修复。据 IDC 数据，2024 年 1-7 月全球智能手机出货量为 5.75 亿台，同比增长 7.66%，国内方面，据工信部数据，2024 年 1-7 月国内智能手机累计出货量为 1.61 亿台，同比增长 13.66%。作为半导体行业最重要的下游终端之一，智能手机出货反弹对 IC 设计企业的业绩构成支撑；其他终端方面，据 Canalys 数据，2024 年第二季度全球 PC 市场出货量达到 6,280 万台，同比增长 3.4%，为连续两个季度实现同比增长，AI PC 的逐步渗透拉动了换机需求，也带动存储、面板等泛半导体零部件的相关需求。

图 29：全球智能手机季度出货量（2018/03-2024/06）图 30：国内智能手机月度出货情况（2022/02-2024/07）



资料来源：IDC，东莞证券研究所



资料来源：工信部，东莞证券研究所

图 31：全球台式机及笔记本出货量（数量单位为千台）

厂商	2024 年 第二季度 出货量	2024 年 第二季度 市场份额	2023 年 第二季度 出货量	2023 年 第二季度 市场份额	年增 长率
联想	14,724	23.4%	14,230	23.4%	3.5%
惠普	13,681	21.8%	13,444	22.1%	1.8%
戴尔	10,078	16.0%	10,329	17.0%	-2.4%
苹果	5,510	8.8%	5,198	8.6%	6.0%
华硕	4,535	7.2%	3,865	6.4%	17.3%
其他	14,280	22.7%	13,669	22.5%	4.5%
合计	62,809	100.0%	60,736	100.0%	3.4%

数据来源：Canalys，东莞证券研究所

### 部分 IC 设计企业业绩梳理

**韦尔股份 (603501)**：公司 2024 年上半年实现营收 120.91 亿元，同比增长 36.50%，实现归母净利润 13.67 亿元，同比增长 792.79%，对应 24Q2 营收为 64.48 亿元，同比增长 42.55%，环比增长 14.24%，对应 24Q2 归母净利润为 8.09 亿元，同比增长 1869.21%，环比增长 45.08%。报告期内，受益于下游需求回暖和产品结构优化，公司 24Q2 营收、归母净利润实现同比、环比提升。手机传感器方面，公司推出了 1.2um5000 万像素的高端图像传感器 OV50H，以及全球首款采用 TheiaCe 技术的智能手机图像传感器 OV50K40，标志着公司在高端产品市场取得重大突破；汽车传感器方面，公司图像传感器业务在汽车市场的收入同比增长 53.06%，推出的 OX08D10 和 OX05D10 图像传感器，均采用了 TheiaCe 技术，具有业界领先的性能，已成功应用于多个汽车平台，未来有望实现稳健成长。

**澜起科技 (688008)**：公司 2024 年上半年实现营收 16.65 亿元，同比增长 79.49%，实现归母净利润 5.93 亿元，同比增长 624.63%，对应 24Q2 营收为 9.28 亿元，同比增长 82.59%，环比增长 25.83%，对应 24Q2 归母净利润为 3.70 亿元，同比增长 495.07%，环比增长 65.50%。盈利能力方面，公司 2024 年上半年销售毛利率为 57.78%，相比上年同期提高 1.45 个百分点，2024 年上半年销售净利率为 35.63%，相比上年同期提高 26.79

个百分点；分季度来看，公司 24Q2 销售毛利率为 57.83%，同比-1.00pct，环比+0.13pct，公司 24Q2 销售净利率为 39.86%，同比+27.61pct，环比+9.55pct。报告期内，全球集成电路行业景气度回暖，而受益于 AI 的强劲需求，全球服务器行业保持较高景气度，在经历 2023 年的行业整体去库存后，2024 年开始恢复性增长。根据 2024 年 7 月 Gartner 发布的《2024 年第一季度全球服务器市场报告》显示，2024 年第一季度全球服务器市场销售额保持增长，销售额 407.5 亿美元，同比增长 59.9%；出货量 282.0 万台，同比增长 5.9%。公司的产品内存接口及模组配套芯片、PCIe Retimer 芯片、MXC 芯片、津逮®CPU 以及混合安全内存模组等主要应用于服务器，因此受益于服务器行业景气回暖，2024 年上半年及 2024 年第二季度景气度实现同比大幅增长，盈利能力有所提升。

**佰维存储（688525）**：公司 2024 年上半年实现营收 34.41 亿元，同比增长 199.64%，实现归母净利润 2.83 亿元，同比增长 195.58%，对应 24Q2 营收为 17.14 亿元，同比增长 137.15%，环比下降 0.72%，对应 24Q2 归母净利润为 1.16 亿元，同比增长 167.93%，环比下降 30.89%。受益存储器行业复苏，报告期内公司业务收入得到显著提升，其中 24H1 存储产品业务收入达到 32.66 亿元，远超上年同期的 10.61 亿元，先进封装与测试业务也有所增长，从 2023H1 的 0.41 亿元提升至 0.66 亿元。

**海光信息（688041）**：公司 2024 年上半年实现营收 37.63 亿元，同比增长 44.08%，实现归母净利润 8.53 亿元，同比增长 25.97%。报告期内，营业收入同比实现较快增长，主要系市场需求增加，客户对公司产品的认可度进一步提升；同时公司持续提升产品性能，加大市场拓展力度，加强与客户及生态伙伴的合作深度与广度，促进了主营业务的较快增长。此外，公司持续加大研发投入力度，产品竞争力不断增强，研发投入同比增长 11.54%，营业收入增幅更大，使研发投入占营业收入比例有小幅下降。

**兆易创新（603986）**：公司 2024 年上半年实现营收 36.09 亿元，同比增长 21.69%，实现归母净利润 5.17 亿元，同比增长 53.88%；对应 2024 年二季度实现营收 19.82 亿元，同比+21.99%，环比+21.78%，对应 24Q2 实现归母净利润 3.12 亿元，同比+67.95%，环比+52.46%。公司坚持多赛道多产品线的组合布局，现有产品主要分为存储器产品、微控制器产品以及传感器产品。报告期内，在 AI 服务器等需求拉动下，全球半导体行业呈复苏态势。公司各项业务恢复顺利，营收、归母净利润实现同比、环比增长，且盈利能力有所提升。

**卓胜微（300782）**：公司 2024 年上半年实现营收 22.85 亿元，同比增长 37.20%，实现归母净利润 3.54 亿元，同比下降 3.32%，对应 24Q2 营收为 10.95 亿元，同比增长 14.84%，环比下降 7.95%，对应 24Q2 归母净利润为 1.57 亿元，同比下降 37.39%，环比下降 20.82%。分品类看，2024 年上半年公司射频分立器件实现收入 12.66 亿元，同比增长 4.74%；射频模组收入 9.66 亿元，同比增长 81.41%。公司在不断巩固并提升原有优势产品市场份额的同时，积极扩大射频模组的开拓力度，其中滤波器模组在产品中成长速度位居第一。2024H1 公司射频模组收入占比已达到 42.29%，且预计占比有望在未来持续增长。

## 2.4 半导体封测：24Q2 营收同比+25.05%，利润同比+74.77%

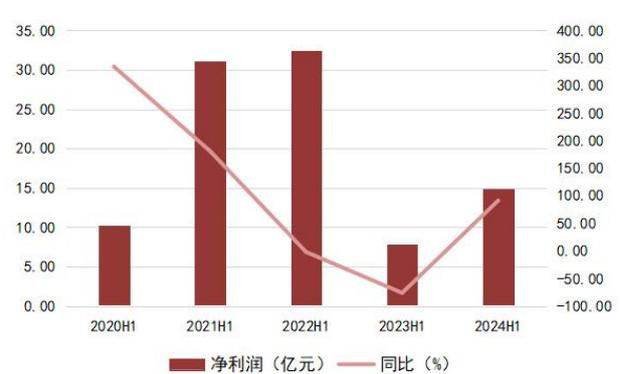
选取申万半导体行业下的三级行业——“集成电路封测”作为半导体封测代表，统计板块 2024 年上半年业绩情况。

**板块业绩：封测板块景气回暖，24H1 营收、归母净利润实现同比大幅增长。**半导体封测板块 2024 年上半年实现营收 386.29 亿元，同比+22.95%，实现归母净利润 14.90 亿元，同比+91.52%；分季度来看，板块 24Q2 实现营收 209.73 亿元，同比+25.05%，环比+18.79%，24Q2 实现归母净利润 10.92 亿元，同比+74.77%，环比+173.59%。

图 32：半导体封测板块 2020H1-2024H1 营收情况



图 33：半导体封测板块 2020H1-2024H1 归母净利润情况



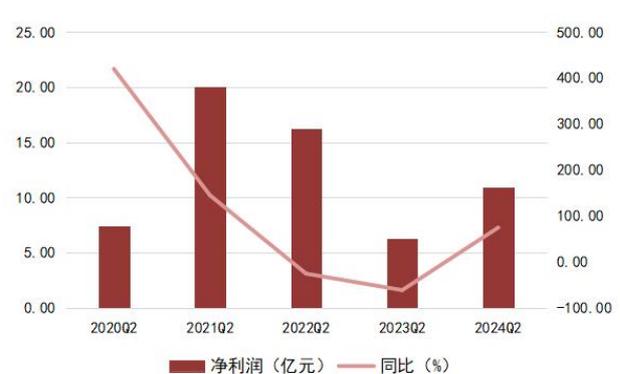
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 34：半导体封测板块 2020Q2-2024Q2 营收情况



图 35：半导体封测板块 2020Q2-2024Q2 归母净利润情况

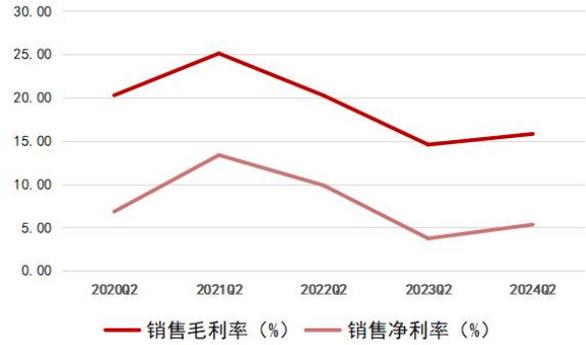


资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

**盈利能力：24Q2 盈利能力实现同比、环比提升。**盈利能力方面，半导体封测板块 2024 年上半年销售毛利率、销售净利率分别为 14.45%和 3.94%，相比上年同期分别提高 1.46 个百分点和 1.52 个百分点。分季度来看，板块 24Q2 销售毛利率为 15.81%，同比+1.24pct，环比+2.97pct，板块 24Q2 销售净利率为 5.34%，同比+1.61pct，环比+3.05pct。

图 36：半导体封测板块 2020H1-2024H1 毛利率、净利率图 37：半导体封测板块 2020Q2-2024Q2 毛利率、净利率 (%)



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

综上所述，半导体封测板块 2023 年景气承压，但 23Q1 构成行业中期底部，之后景气度逐季回暖。进入 2024 年以来，随着消费市场需求趋于稳定、存储器市场回暖、人工智能与高性能计算等热点应用领域带动等因素作用，2024 年全球半导体市场重回增长轨道，封测板块作为半导体产业链的下游环节深度受益，业内企业产能利用率、经营业绩均呈恢复态势。

### 部分半导体封测企业业绩梳理

**长电科技（600584）**：进入 2024 年以来，随着消费市场需求趋于稳定、存储器市场回暖、人工智能与高性能计算等热点应用领域带动等因素作用，2024 年全球半导体市场重回增长轨道。根据 WSTS 数据统计，2024 年上半年全球半导体销售额为 2,908 亿美元，同比增长 18.1%，其中中国半导体销售额为 872.3 亿美元，同比增长 25.28%，增速快于全球平均水平。受益下游需求回暖，公司经营业绩实现同比、环比增长。营收方面，公司 24Q2 实现营收 86.45 亿元，同比+36.94%，环比+26.34%，单季度营收创历史同期新高；净利润方面，公司 24Q2 实现归母净利润 4.84 亿元，同比+25.51%，环比+2.50%，净利润增速小于营收增速，主要为 24H1 非经常性损益减少（公司 24H1 政府补助等非经常性损益较上年同期减少 0.39 亿元），影响了公司利润端表现。盈利能力方面，公司 24Q2 销售毛利率为 14.28%，同比下降 0.83pct，环比提升 2.08pct，24Q2 销售净利率为 5.59%，同比下降 0.52pct，环比提升 3.64pct。报告期内，公司旗下工厂稼动率持续提升，带来销售毛利率、净利率实现环比改善。

**通富微电（002156）**：据公司半年报，公司 2024 年上半年实现营收 110.80 亿元，同比增长 11.83%，实现归母净利润 3.23 亿元，同比增长 271.91%，对应 24Q2 营收为 57.98 亿元，同比增长 10.10%，环比增长 9.77%，对应 24Q2 归母净利润为 2.24 亿元，同比增长 216.61%，环比增长 127.60%。盈利能力方面，公司 2024 年上半年销售毛利率为 14.16%，相比上年同期提高 3.74 个百分点，2024 年上半年销售净利率为 3.30%，相比上年同期提高 5.36 个百分点；分季度来看，公司 24Q2 销售毛利率为 16.00%，同比+4.73 pct，环比+3.86pct，公司 24Q2 销售净利率为 4.31%，同比+8.39pct，环比+2.11pct。进入 2024 年以来，随着消费市场需求趋于稳定、存储器市场回暖、人工智能与高性能计算等热点应用领域带动等因素作用，2024 年全球半导体市场重回增长轨道。根据 WSTS 数据

统计，2024 年上半年全球半导体销售额为 2,908 亿美元，同比增长 18.1%，其中中国半导体销售额为 872.3 亿美元，同比增长 25.28%，增速快于全球平均水平。受益高性能计算、AI 手机、AI PC 等因素驱动，公司 24Q2 经营业绩实现同比、环比高速增长，且盈利能力有所提升。

**华天科技（002185）：**据公司半年报，公司 2024 年上半年实现营收 67.18 亿元，同比增长 32.02%，实现归母净利润 2.23 亿元，同比增长 254.23%，对应 24Q2 营收为 36.12 亿元，同比增长 26.75%，环比增长 16.30%，对应 24Q2 归母净利润为 1.66 亿元，同比下降 2.10%，环比增长 190.53%。盈利能力方面，公司 2024 年上半年销售毛利率为 10.91%，相比上年同期提高 2.99 个百分点，2024 年上半年销售净利率为 3.45%，相比上年同期提高 1.97 个百分点；分季度来看，公司 24Q2 销售毛利率为 12.96%，同比+1.95 pct，环比+4.44pct，公司 24Q2 销售净利率为 2.81%，同比-2.27pct，环比+2.96pct。报告期内，公司所处集成电路行业景气度逐步复苏，以及与下游汽车电子、高速运算、人工智能、存储器等终端客户交流合作有所加深，带动公司订单和产品销量同比增加。

## 2.5 集成电路制造：24Q2 营收同比+8.88%，归母净利润同比-36.06%

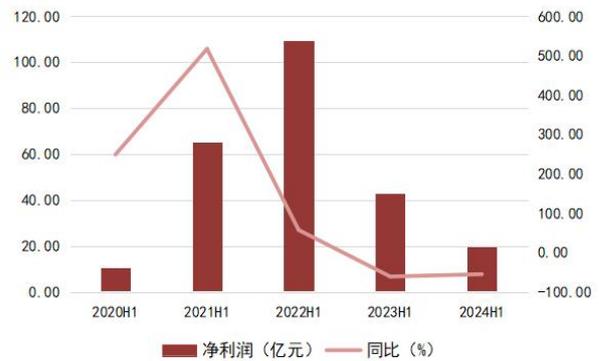
选取申万半导体行业下的三级行业——“集成电路制造”作为集成电路制造板块代表，统计板块 2024 年上半年业绩情况。

**板块业绩：产能利用率逐步修复，Q2 利润环比改善。**集成电路制造板块 2024 年上半年实现营收 461.85 亿元，同比+10.64%，实现归母净利润 19.46 亿元，同比-54.68%；分季度来看，板块 24Q2 实现营收 239.86 亿元，同比+8.88%，环比+8.05%，24Q2 实现归母净利润 13.00 亿元，同比-36.06%，环比+101.60%。

图 38：集成电路制造板块 2020H1-2024H1 营收情况



图 39：集成电路制造板块 2020H1-2024H1 归母净利润情况

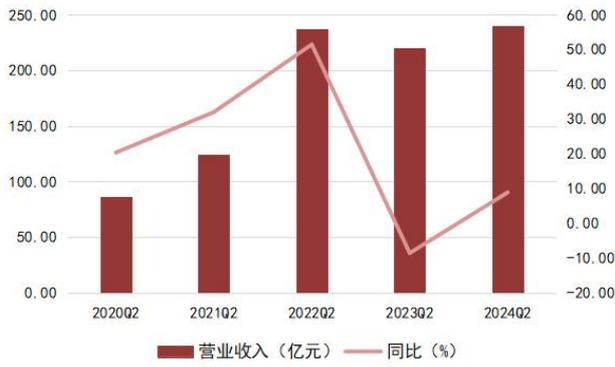


资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

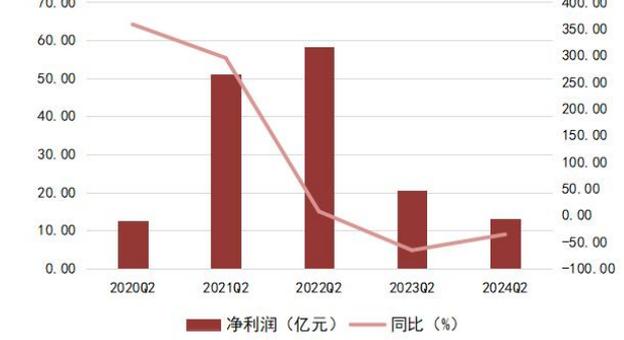
图 40：集成电路制造板块 2020Q2-2024Q2 营收情况

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 41：集成电路制造板块 2020Q2-2024Q2 归母净利润情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所



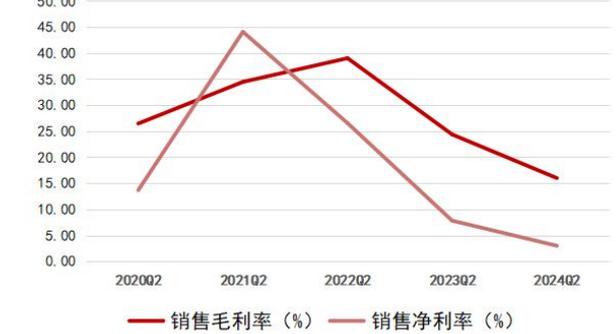
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

**盈利能力：Q2 盈利能力同比下滑但环比提升。** 盈利能力方面，半导体制造板块 2024 年上半年销售毛利率、销售净利率分别为 15.89% 和 0.99%，相比上年同期分别下降 8.93pct 和 8.51pct，板块 24Q2 销售毛利率为 16.00%，同比-8.37pct，环比+0.22pct，板块 24Q2 销售净利率为 3.01%，同比-4.81pct，环比+4.20pct。

图 42：集成电路制造板块 2020H1-2024H1 毛利率、净利率 (%) 图 43：集成电路制造板块 2020Q2-2024Q2 毛利率、净利率 (%)



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

综上所述，2024 年，全球晶圆代工行业缓慢复苏，且受地缘政治影响，国内晶圆代工本土化需求加速提升，对应申万晶圆制造板块 24Q2 营收实现同比、环比改善，但行业面临代工价格下降、折旧费用增加等挑战，影响板块利润表现。以中芯国际为例，公司 24Q2 营收实现同比、环比增长，但归母净利润同比下降，且盈利能力承压。随着公司 12 英寸产能持续释放，公司产品组合有望实现优化调整，因此公司预计 24Q3 收入环比增长 13% 至 15%，毛利率介于 18% 到 20% 范围内，指引较为积极。

### 部分集成电路制造企业业绩梳理

**中芯国际（688981）：** 据公司半年报，公司 2024 年上半年实现营收 262.69 亿元，同比增长 23.23%，实现归母净利润 16.46 亿元，同比下降 45.07%，对应 24Q2 营收为 136.76

亿元，同比增长 23.10%，环比增长 8.59%，对应 24Q2 归母净利润为 11.37 亿元，同比下降 19.11%，环比增长 123.46%。盈利能力方面，公司 2024 年上半年销售毛利率为 13.91%，相比上年同期下降 8.53 个百分点，2024 年上半年销售净利率为 6.25%，相比上年同期下降 11.00 个百分点；分季度来看，公司 24Q2 销售毛利率为 13.65%，同比-8.49 pct，环比-0.54pct，公司 24Q2 销售净利率为 8.71%，同比-7.83pct，环比+5.14pct。2024 年上半年，全球半导体产业整体呈现复苏迹象，产业链回暖趋势基本确立，晶圆代工作为产业链前端的关键行业迎来一定的需求反弹，带动公司 24H1 营收实现同比增长，24Q2 营收实现同比、环比增长。盈利能力方面，报告期内公司 12 英寸产能建设加速，逆势扩产导致折旧费用同比增加，叠加报告期内晶圆代工价格降低影响了企业的盈利能力，导致公司盈利能力承压。

据公司此前港股发布的 24Q2 未经审核业绩公告，公司对 24Q3 收入指引为环比增长 13% 至 15%，毛利率介于 18%到 20%范围内，指引较为积极。进入 24Q3，受地缘政治影响，本土化需求加速提升，主要市场领域的芯片套片产能供不应求，公司 12 英寸产能紧俏，价格向好。产品结构方面，公司今年扩产都在 12 英寸，附加值相对较高，新扩充产能得到充分利用并带来收入，促进产品组合优化调整，因此公司对 24Q3 展望乐观。

**华虹公司（688347）：**据公司半年报，公司 2024 年上半年实现营收 67.32 元，同比下降 23.88%，实现归母净利润 2.65 亿元，同比下降 83.33%，对应 24Q2 营收为 34.35 亿元，同比下降 23.15%，环比增长 4.17%，对应 24Q2 归母净利润为 0.43 亿元，同比下降 92.07%，环比下降 80.53%，盈利能力方面，公司 2024 年上半年销售毛利率为 16.34%，相比上年同期下降 17.91 个百分点，2024 年上半年销售净利率为-7.20%，相比上年同期下降 18.65 个百分点；分季度来看，公司 24Q2 销售毛利率为 17.74%，同比-14.95 pct，环比+2.84pct，公司 24Q2 销售净利率为-8.77%，同比-9.79pct，环比-3.20pct。报告期内，公司立足于先进“特色 IC+功率器件”的战略目标，以拓展特色工艺技术为基础，提供包括嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多元化特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。报告期内公司营收同比减少，主要原因是产品 ASP 下降，而环比增长则主要是因为下游回暖带来的出货量提升。公司对 24Q3 营收指引为 5 亿-5.2 亿美元，毛利率区间为 10%—12%，长期目标位为提高海外收入比例，未来将在全球接洽 IDM 和 Fabless 客户以拓展渠道。

### 3. 投资建议

**投资建议：半导体行业景气度延续，维持板块超配评级。**进入 2024 年，伴随着下游需求回暖以及厂商推进库存去化，半导体行业迈入上行周期，从半年报业绩看，半导体行业 2024 年上半年经营业绩实现同比增长，设备、材料、存储、CIS、封测等细分板块龙头企业 Q2 业绩大多表现出色，且受益智能手机等消费类电子的强劲需求，苹果、高通、联电等海外企业最新财季业绩高于预期，表明行业景气度延续。展望下半年，随着消费电子旺季的到来和内资晶圆厂产能扩充持续推进，半导体行业景气度有望维持较好水平。可关注 Q2 业绩表现出色的设备、存储、CIS、封测等细分板块。

**建议关注标的：**

- **半导体设备与材料：**北方华创（002371）、华海清科（688120）、拓荆科技（688072）、长川科技（300604）、鼎龙股份（300054）、江丰电子（300666）；
- **存储芯片：**兆易创新（603986）、澜起科技（688008）、佰维存储（688525）；
- **模拟芯片：**圣邦股份（300661）；
- **先进封装：**长电科技（600584）、通富微电（002156）；
- **射频&CIS：**卓胜微（300782）、韦尔股份（603501）、思特威（688213）；
- **算力芯片：**海光信息（688041）
- **晶圆代工：**中芯国际（688981）

#### 4. 风险提示

**（1）终端需求不及预期：**半导体行业已进入上行周期，从 24Q2 业绩看产业趋势已经明确，以智能手机为代表的终端需求回暖对板块业绩构成支撑。若后续下游需求不及预期，则可能对相关上市公司业绩造成不利影响；

**（2）国产替代不及预期：**半导体设备与材料、高端元器件等领域的国产替代是大势所趋，若产业链公司技术突破不如预期导致国产替代进程受阻，则可能面临业绩增速放缓的风险；

**（3）价格竞争加剧：**目前在集成电路、被动元器件等领域，国内上市企业以生产中低端产品为主，高端领域国产替代空间较大。若上市企业进行大量产能扩张，则行业未来可能面临产能过剩的局面，带来价格竞争导致盈利能力下滑的风险。

表 1：重点公司盈利预测及投资评级（截至 2024/9/3）

股票代码	股票名称	股价 (元)	EPS (元)			PE (倍)			评级	评级变动
			2023A	2024E	2025E	2023A	2024E	2025E		
002371	北方华创	311.49	7.34	10.82	15.00	135	29	21	买入	维持
688120	华海清科	127.55	4.55	4.47	5.85	71	29	22	买入	维持
688072	拓荆科技	121.31	3.52	3.22	4.52	89	38	27	买入	维持
300604	长川科技	29.49	0.07	0.86	1.31	580	34	23	买入	维持
300054	鼎龙股份	19.43	0.24	0.48	0.67	57	41	29	买入	维持
300666	江丰电子	49.60	0.96	1.31	1.76	58	38	28	买入	维持
603986	兆易创新	70.02	0.24	1.62	2.61	59	43	27	买入	维持
688008	澜起科技	52.94	0.40	1.19	2.20	60	44	24	买入	维持
688525	佰维存储	43.93	-1.45	1.24	1.71	61	35	26	买入	维持
300661	圣邦股份	70.39	0.59	0.90	1.43	62	78	49	买入	维持
600584	长电科技	31.01	0.82	1.13	1.68	64	27	18	买入	维持

002156	通富微电	19.15	0.11	0.60	0.87	65	32	22	买入	维持
300782	卓胜微	63.73	2.10	1.54	2.35	66	41	27	买入	维持
603501	韦尔股份	87.56	0.47	2.54	3.60	67	34	24	买入	维持
688213	思特威	47.60	0.04	3.54	1.56	68	13	30	买入	维持
688041	海光信息	77.32	0.54	4.54	1.04	69	17	74	买入	维持
688981	中芯国际	46.26	0.61	0.59	0.76	70	78	61	买入	维持

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

注：北方华创、兆易创新、澜起科技、长电科技、通富微电、中芯国际 2024/2025 年 EPS 采用报告预测值，其他公司 2024/2025 年 EPS 用同花顺一致预测值

**东莞证券研究报告评级体系：**

公司投资评级	
买入	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 15%以上
增持	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 5%-15%之间
持有	预计未来 6 个月内，股价表现介于市场指数±5%之间
减持	预计未来 6 个月内，股价表现弱于市场指数 5%以上
无评级	因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，导致无法给出明确的投资评级；股票不在常规研究覆盖范围之内
行业投资评级	
超配	预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 10%以上
标配	预计未来 6 个月内，行业指数表现介于市场指数±10%之间
低配	预计未来 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

说明：本评级体系的“市场指数”，A 股参照标的为沪深 300 指数；新三板参照标的为三板成指。

证券研究报告风险等级及适当性匹配关系	
低风险	宏观经济及政策、财经资讯、国债等方面的研究报告
中低风险	债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告
中风险	主板股票及基金、可转债等方面的研究报告，市场策略研究报告
中高风险	创业板、科创板、北京证券交易所、新三板（含退市整理期）等板块的股票、基金、可转债等方面的研究报告，港股股票、基金研究报告以及非上市公司的研究报告
高风险	期货、期权等衍生品方面的研究报告

投资者与证券研究报告的适当性匹配关系：“保守型”投资者仅适合使用“低风险”级别的研报，“谨慎型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中低风险”的研报，“稳健型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中风险”的研报，“积极型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中高风险”的研报，“激进型”投资者适合使用我司各类风险级别的研报。

**证券分析师承诺：**

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地在所知情的范围内出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点，不受本公司相关业务部门、证券发行人、上市公司、基金管理公司、资产管理公司等利益相关者的干涉和影响。本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系，没有利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益，或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点。

**声明：**

东莞证券股份有限公司为全国综合性综合类证券公司，具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供东莞证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠，但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可随时更改。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可跌可升。本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反。在任何情况下，本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并不构成对任何人的投资建议。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，据此报告做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司及其所属关联机构在法律许可的情况下可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、经纪、资产管理等服务。本报告版权归东莞证券股份有限公司及相关内容提供方所有，未经本公司事先书面许可，任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登。如引用、刊发，需注明本报告的机构来源、作者和发布日期，并提示使用本报告的风险，不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本证券研究报告的，应当承担相应的法律责任。

**东莞证券股份有限公司研究所**

广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 24 楼

邮政编码：523000

电话：（0769）22115843

网址：www.dgzq.com.cn